

**Petek, 3. april 2026**

Pozdravljeni,

pošiljamo vam pregled izbranih informacij in novosti s področja čipov, polprevodnikov ter aktivnosti KC Čip.si

## Novosti KC Čip.si

V današnjem novičniku želimo izpostaviti:

- **[Nanocenter – infrastrukturni center, kjer je na voljo raziskovalna infrastruktura za napredne materiale in nanotehnologije.](#)**  
[Nanocenter](#) omogoča dostop do vrhunske opreme za sintezo, karakterizacijo in nanofabrikacijo naprednih materialov. S celovito podporo spodbuja razvoj od temeljnih raziskav do konkretnih aplikacij. Za več informacij si oglejte katalog opreme na [povezavi](#).  
Raziskovalna infrastruktura Nanocenter temelji na vrhunski opremi za sintezo in karakterizacijo naprednih materialov ter nanostruktur. Vključuje napredne mikroskopske sisteme (npr. FIB, TEM, UHV STM), opremo za nanofabrikacijo (elektronska litografija, čisti prostori) ter tehnologije za nanašanje tankih plasti, kot sta molekularna epitaksija (MBE) in pulzno lasersko nanašanje (PLD).  
Oprema je organizirana kot odprta večuporabniška infrastruktura, ki omogoča dostop raziskovalcem in industriji ter podpira celoten inovacijski cikel – od temeljnih raziskav do razvoja prototipov in industrijskih aplikacij. S tem Nanocenter deluje kot pomemben infrastrukturni partner v nacionalnih in evropskih projektih ter prispeva k prenosu znanja in krejitvi konkurenčnosti.  
Podprt z visoko usposobljeno strokovno ekipo in naprednimi laboratoriji (npr. za kvantne naprave in nanofabrikacijo), Nanocenter zagotavlja prilagodljive, visokokakovostne storitve ter spodbuja sodelovanje med akademskim in industrijskim okoljem v skladu z načeli odprte znanosti in evropskih raziskovalnih infrastruktur.
- **[Intervju SRIP ACS+ s koordinatorjem projekta KC Čip.si](#)**, prof. dr. Janezom Krčom z naslovom: »Brez čipov ni sodobnega življenja« Vabimo vas, da si ga preberete.

## Dogodki:

- **[Webinar: Launch your fabless future: EuroCDP Venture Building Programmes for European Startups, EuroCDP](#)**  
8 april 2026, 15:00, on-line

Predstavitev programa EuroCDP za pospeševanje evropskih fabless startupov, ki ponujajo dostop do načrtovalskih orodij in mreže strokovnjakov za hitrejši razvoj prvega integriranega vezja.

- **Konferenca: [EUROSimE 2026 - 27th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems](#)**  
19.-22. april 2026, Varšava, Poljska  
Konferenca bo predstavila najnovejše rezultate raziskav ter industrijske aplikacije s področja toplotnih, mehanskih in večfizikalnih simulacij v mikro- in nanoelektroniki.
- **Forum: [EPoSS Annual Forum 2026](#)**  
16.-19. Junij 2026, Braga, Portugal  
Program bo zajemal razprave o Chips Act 2.0, organizirane bodo izbrane tematske seje, izvedba tekmovanja start-upov, panel o prihodnosti fotonike ter drugo.

### Razpisi:

- **[Lab to Fab Accelerators for Advanced Packaging and Heterogeneous Integration](#)**  
DIGITAL-JU-Chips-2025-SG-LFA  
LFA projekti namenjeni koordiniraji, podpiraji in pospešujeji uvajanje najnovejših tehnologij pakiranja v evropsko industrijo ter omogočajo nemoten prenos tehnologij po zaključku projekta.
- **[Lab to Fab Accelerator Ecosystem, Coordination and Support Action DIGITAL-JU-CHIPS-2025-CSA-LFA](#)**  
Za predloge projektov, ki bodo na konkretnih primerih omogočali hitrejšo prenos naprednih tehnologij pakiranja ter prenos rešitev s pilotnih linij Chips JU do končnih uporabnikov v industriji.

Rok za prijavo je 7. maj 2026

### Ostale novice:

- **[Implementation dialogue on the Chips Act](#)**  
Evropska komisija in industrija so v dialogu o Evropskem aktu o čipih razpravljali o izvajanju ukrepov in prihodnji nadgradnji (Chips Act 2.0) za krepitev konkurenčnosti in odpornosti evropskega polprevodniškega ekosistema. [Naslov do poročila.](#)

Želimo vam prijetne praznike,  
vaš KC Čip.si



## Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

### KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: [office@cc-chip.si](mailto:office@cc-chip.si)

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran (v izdelavi): <https://cc-chip.si/>



Financira  
Evropska unija



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREENOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljali na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)

